

証券コード：6599

EBRAIN エブレン株式会社

The background of the slide is a futuristic cityscape with a blue and white color scheme. The buildings are stylized and appear to be constructed from circuitry or data lines. A bright light source is visible in the upper right quadrant, creating a lens flare effect. The word "EBRAIN" is prominently displayed in the center of the image in a bold, red, italicized font.

EBRAIN

2023年3月期末 会社説明資料

- 会社概要
- 事業内容の説明
- 2023年3月期通期(第50期)決算状況
- 2024年3月期(第51期)見通し
- 成長への取り組み

設	立	1973年（昭和48年）10月		
本	社	東京都八王子市石川町		
資	本	金	1億4,301万円	
売	上	高	42億5,800万円（2023年3月期）	
経	常	利	益	6億5,400万円（同上）
従	業	員	数	114名（2023年3月現在）
事	業	所	東京都八王子市、東京都荒川区、埼玉県入間市、大阪市東淀川区	
子	会	社	蘇州エブレン（蘇州惠普聯電子有限公司：中国江蘇省蘇州市）	
事	業	内	容	産業用電子機器・工業用コンピュータの設計製造販売

- 現在のメインの仕事内容は、
通信・電力・鉄道・医療などの「**社会インフラ系設備**」および
半導体製造装置や生産自動化機械などの「**産業インフラ系設備**」に、
コントローラーとして使用される**産業用コンピュータ**の
受託設計と受託生産が中心で、売上の80%以上を占めています。

通信・放送



- 鉄道・電力・通信などの公共性の高い事業会社向け設備の開発や調達は、
大手の装置メーカーが主契約者となっていて、私どものビジネスのポジシ
ョンとしては、その下になります。

鉄道



- 主契約者の装置メーカーは、設備やシステムの開発構想に基づいて、
当社へ委託するコンピュータ製品の「**要求仕様書**」を作成して提示し、
私共はその「**要求仕様**」に基づいて**製品を設計**し、試作品を作って装置
メーカーへ送り、評価と設計検証を受けます。

医療

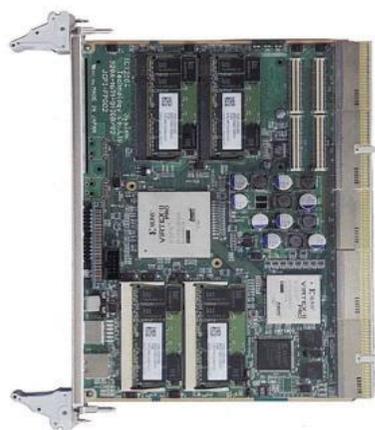


- 量産に入る迄に半年とか一年以上の期間を要する事もありますが、
量産開始以降は中長期的に安定した製品供給を要求されます。

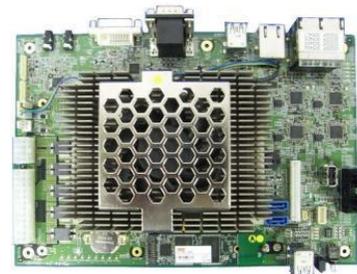
半導体製造装置



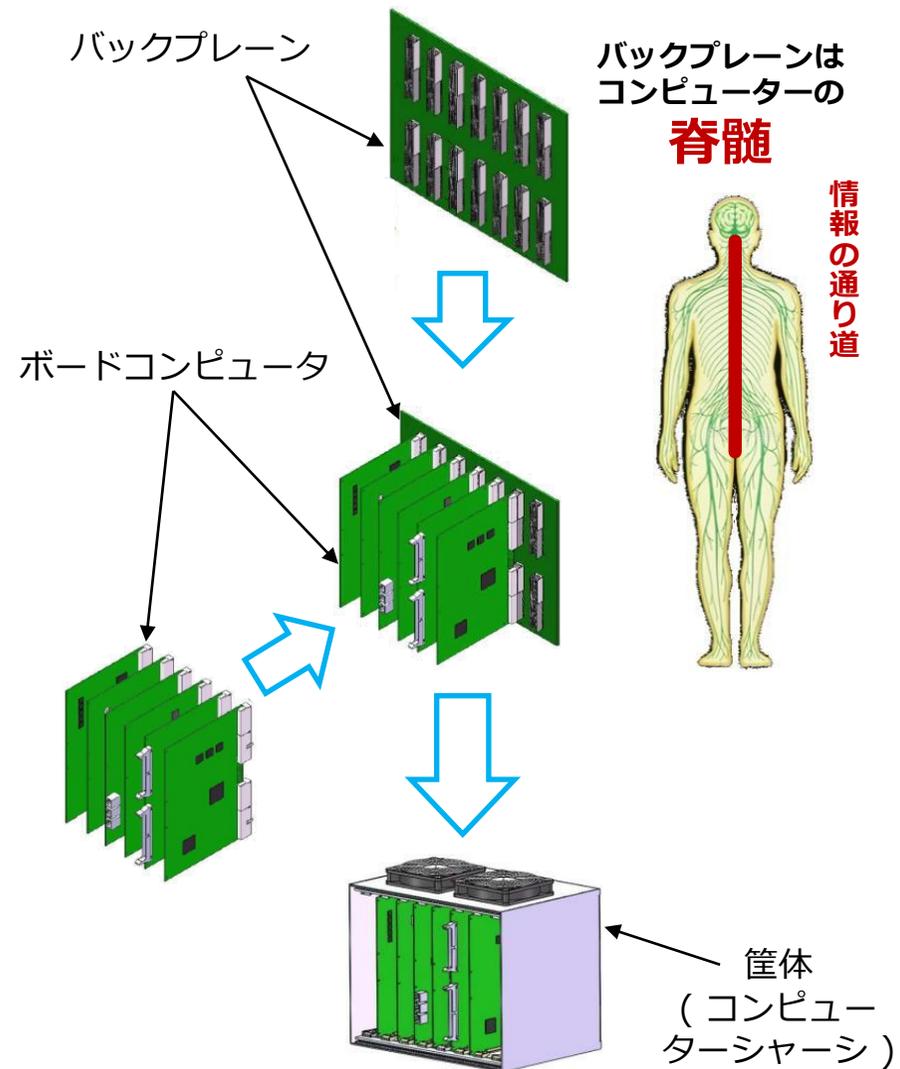
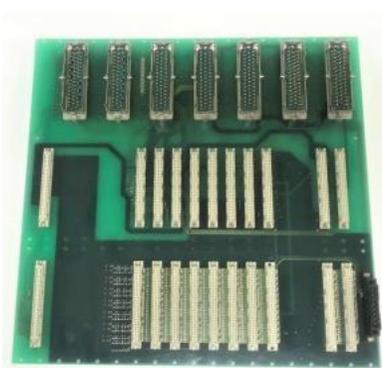
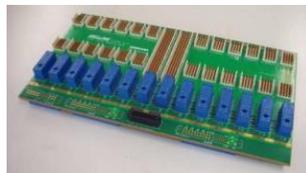
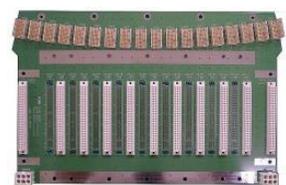
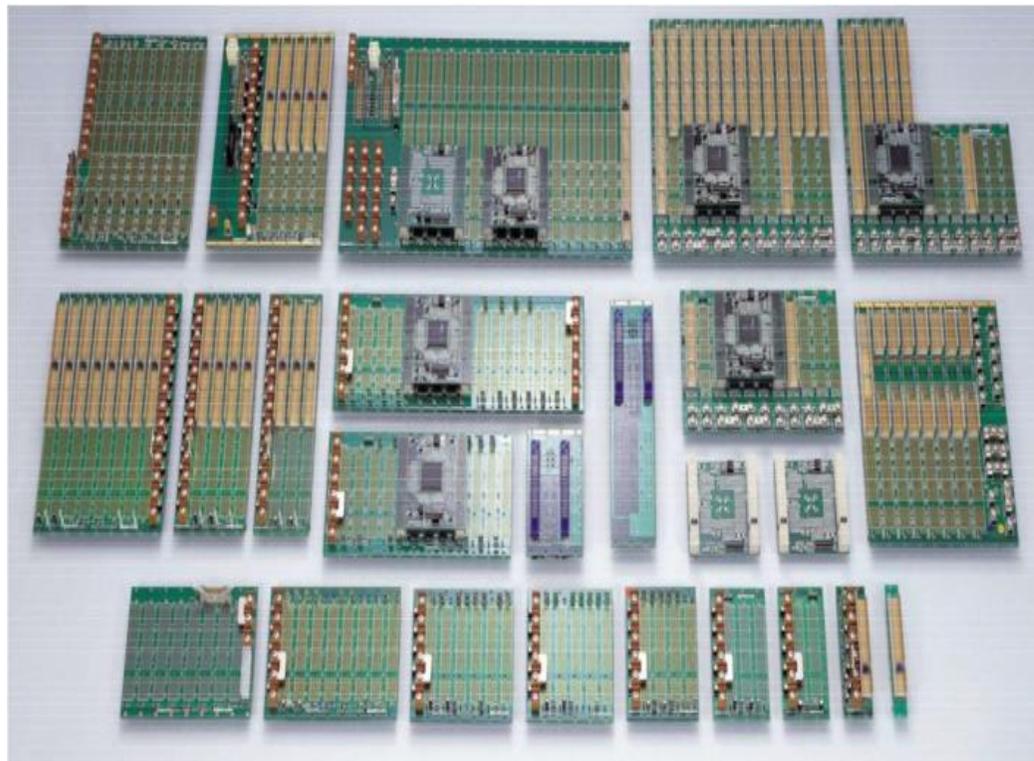
- バックプレーンシステム用
ボードコンピュータ



- IoT・Edge システム用
ワンボードコンピュータ



製品区分(2) バックプレーン

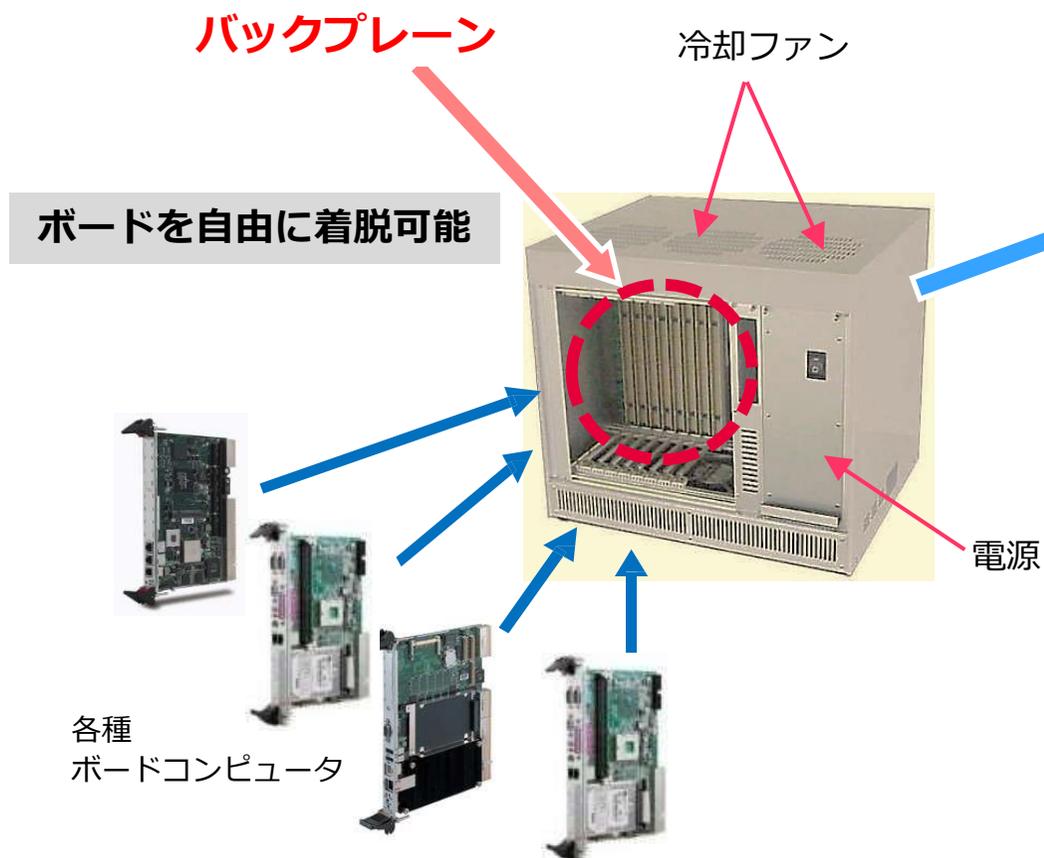


- バスラック
(バックプレーン搭載型シャーシ)



- ワンボード型シャーシ
(IoT・Edgeシステム用)





(例・半導体製造装置)

バックプレーン

【役割】
各種回路基板を相互に接続して
信号伝送や電力供給を行う

冷却ファン

筐体

ガイドレール

電源



ボードコンピュータ

【バックプレーン方式の利点】

ボードコンピュータが自在に着脱可能

1. 保守性

ホットスワップ、
保守体制、保守要員、

2. 拡張性

拡張スロット、増設、
機能追加、

3. 汎用性

市場に流通しているボードコンピュータ
を採用する事が可能。

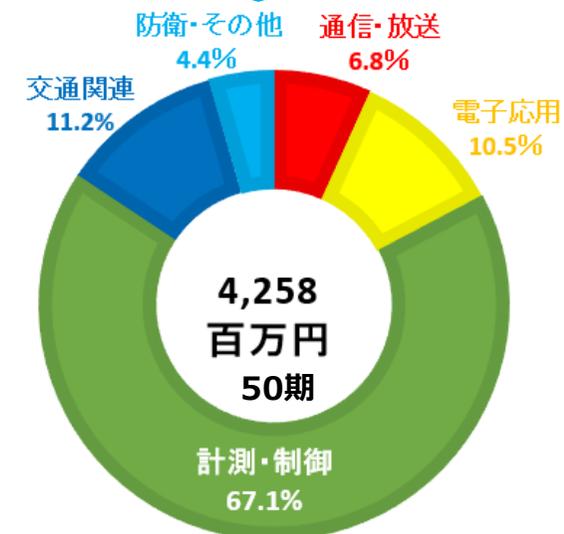
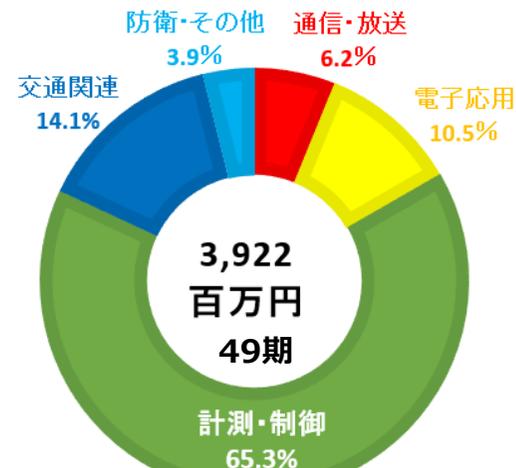
多くの産業用コンピュータで
バックプレーン方式が採用される

エブレン製品の用途（応用分野）

産業インフラ・社会インフラ関連の大手企業と安定的な取引関係を継続



連結売上高構成比



主要納入先 (直接納入,間接納入を含む)

各分野の主要メーカーへ納入

NEC

NEC グループ各社

HITACHI
Inspire the Next

日立製作所
グループ各社

FUJITSU

富士通グループ各社

住友電工
Connect with Innovation

住友電気工業 (株)

GE Healthcare

GE Healthcare
グループ各社

Preferred Networks

(株) プリファード・
ネットワークス

三菱重工

三菱重工
グループ各社

MITSUBISHI ELECTRIC

三菱電機
グループ各社

Kawasaki

川崎重工業
グループ各社

TEL

東京エレクトロン
グループ各社

Canon

キヤノンメディカル
システムズ (株)

古河電工

古河電気工業 (株)

KYOSAN

(株) 京三製作所

viswill

第一実業ビスウィル (株)

Panasonic

パナソニック
グループ各社

TOSHIBA

東芝 グループ各社

Lasertec

レーザーテック (株)

OLYMPUS

オリンパスメディカル
システムズ (株)

Nikon

(株) ニコン

SCREEN

(株) SCREENセミコンダクター
ソリューションズ

日本信号株式会社

日本信号 (株)

SONY

ソニーグローバル
マニュファクチャリング&
オペレーションズ

MEIDEN

(株) 明電舎

TOKYO KEIKI

東京計器 (株)

Anritsu

アンリツ (株)

SAMSUNG

サムスン電子
グループ各社

USHIO

ウシオ電機 (株)

ONO SOKKI

(株) 小野測器

BCPの観点から共通の設備で複数の生産拠点で生産

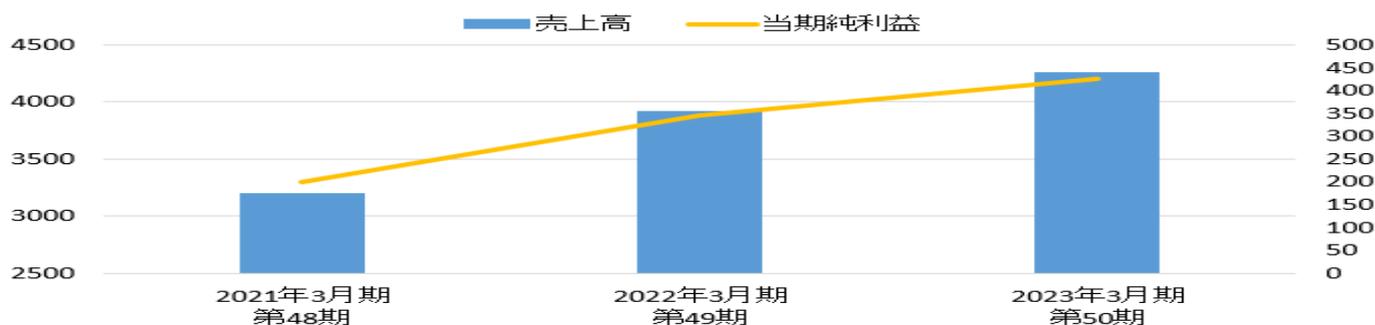




2023年3月期（50期）業績報告

2023年3月期（第50期）決算実績

連結損益計算書	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期 (前年同期比)	50期計画 (達成率)
売上高	3,202	3,922	4,258 (108.6%)	4,320 (98.6%)
営業利益	298	537	656 (122.1%)	650 (100.9%)
営業利益率	9.3%	13.6%	15.4%	
経常利益	300	529	654 (123.4%)	650 (100.6%)
経常利益率	9.3%	13.4%	15.3%	
当期純利益	200	345	426 (123.4%)	430 (99.1%)
当期純利益率	6.2%	8.7%	10.0%	



単位：百万円

計測・制御 (半導体製造装置)

- ✓ 先行的な調達で部材調達難による出荷停止を回避
- ✓ メモリ供給過多の影響でメモリ半導体製造装置の設備投資は一部凍結
- ✓ 中国輸出規制の影響でロジック半導体製造装置の生産調整も一部発生
- ✓ しかし世界的なロジック半導体不足解消に向け設備投資は継続して増加
- ✓ マイナス影響をプラス影響が上回り、前年同期比**11.6%増**となった
2,560百万円→2,856百万円 (296百万円↑)

交通関連

- ✓ 移動制限の影響による鉄道会社の業績悪化に伴う設備投資延期
- ✓ 海外向け鉄道関連の入札延期、設置工事遅延
- ✓ 顧客が調達する半導体の入手遅れによる納入制限
- ✓ 売上は前年同期比**14.1%減**
554百万円→476百万円 (78百万円↓)

通信・放送

- ✓ 第4四半期にネットワーク機器で特需
- ✓ 電力関連の新機種量産開始
- ✓ 売上は前年同期比**19.2%増**
241百万円→287百万円 (46百万円↑)

電子応用

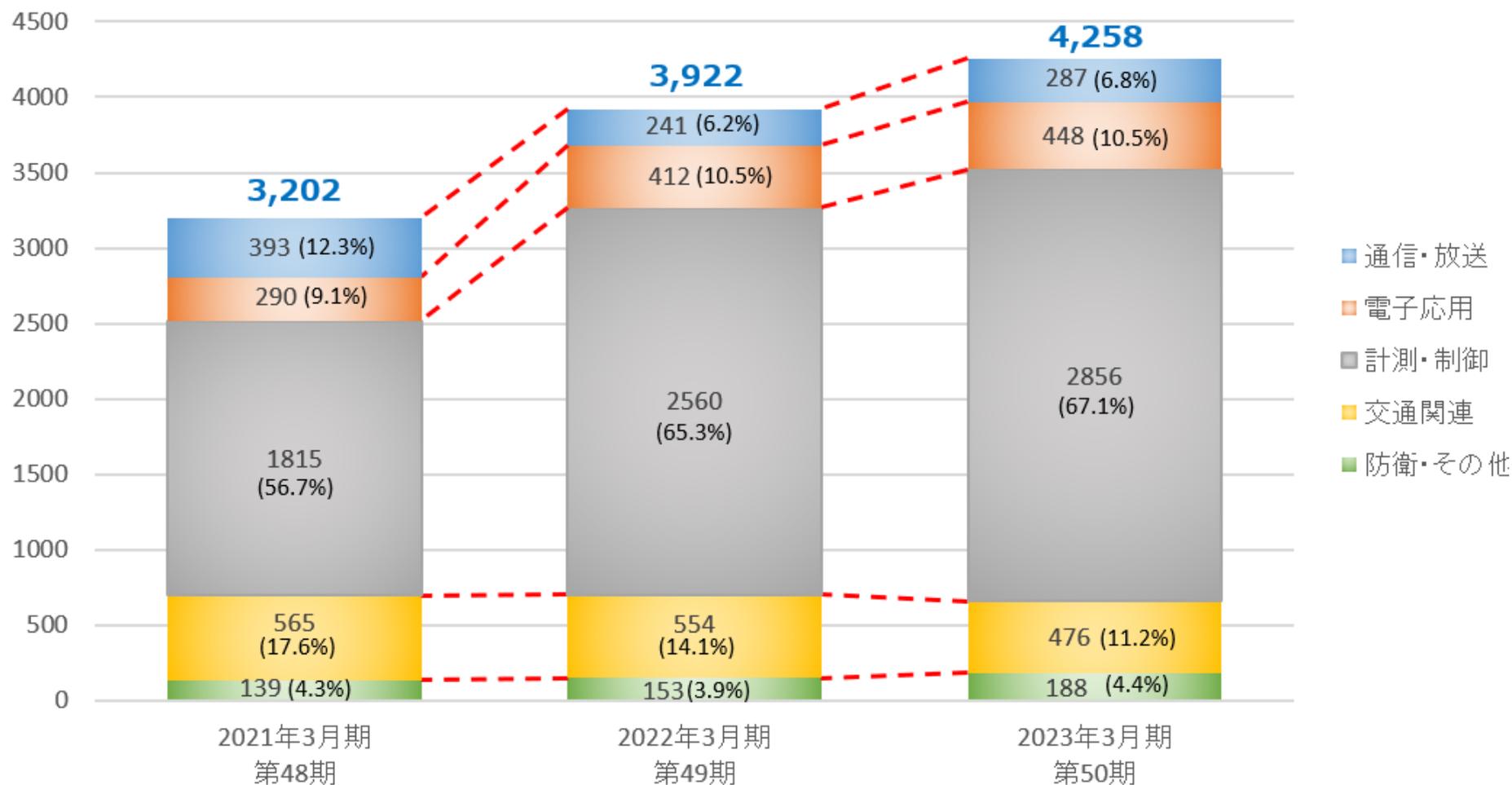
- ✓ 第1四半期に中国のロックダウンの影響で納入が滞る
- ✓ 第2四半期以降ロックダウン解除により復調、第3四半期から増加に転じる
- ✓ 売上は前年同期比**8.8%増**
412百万円→448百万円 (36百万円↑)

防衛・その他

- ✓ 部品の遅れから49期納入分が50期納入に後ろ倒し
- ✓ 売上は前年同期比**23.0%増**
153百万円→188百万円 (35百万円↑)

連結応用分野別売上同四半期比推移

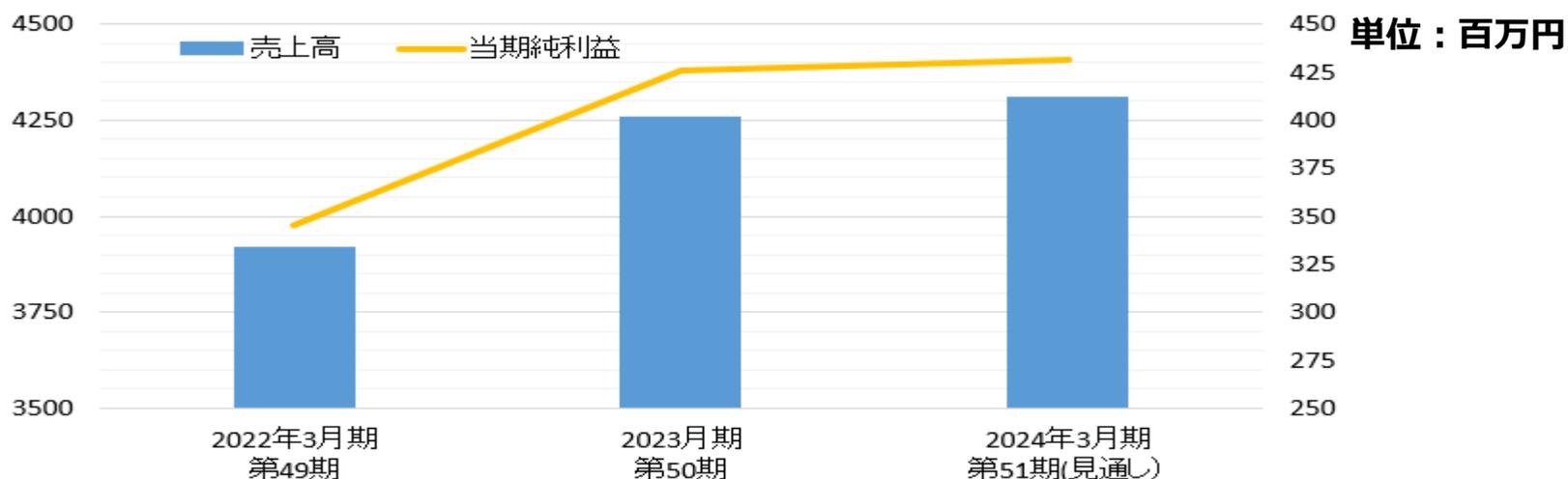
単位:百万円



	2022.3 (百万円)	2023.3 (百万円)	前期末比
流動資産	3,907	4,325	110.7%
固定資産	1,277	1,278	100.1%
資産合計	5,184	5,604	108.1%
流動負債	1,018	1,014	99.6%
固定負債	374	393	105.1%
負債合計	1,392	1,407	101.1%
純資産	3,791	4,197	110.7%
負債純資産合計	5,184	5,604	108.1%
自己資本比率	73.1%	74.9%	

2024年3月期 (第51期) 通期予想

連結損益計算書	2022.3 49期	2023.3 50期	2024.3 51期見通し	増減率
売上高	3,922	4,258	4,310	101.2%
営業利益	537	656	659	100.4%
営業利益率	13.6%	15.4%	15.2%	
経常利益	529	654	659	100.7%
経常利益率	13.4%	15.3%	15.2%	
当期純利益	345	426	431	101.1%
当期純利益率	8.7%	10.0%	10.0%	



一般産業用途の半導体不足は未だに多方面に影響を及ぼしている

計測・制御 (半導体製造装置)

- ✓ メモリ半導体関連製造装置の増産は第4四半期頃を予想
- ✓ ウクライナ問題の長期化による半導体材料供給難懸念
- ✓ ChatGPT等のAI活用増大によるデータセンター投資に期待
- ✓ 中国向け半導体製造装置輸出規制の影響懸念

交通関連

- ✓ 移動制限解除に伴い鉄道関連を中心に設備投資再開
- ✓ 半導体調達難による顧客での納入制限が調達進展により徐々に解消

一般産業用途の半導体不足は未だに多方面に影響を及ぼしている



通信・放送

- ✓ 通信・電力関連は景況感は前年並みで推移
- ✓ 電力分野で新規案件の量産開始を計画



電子応用

- ✓ ウクライナ問題長期化による欧州向けの先行き不透明感
- ✓ ChatGPT等AIディープラーニング向けHPC投資に期待

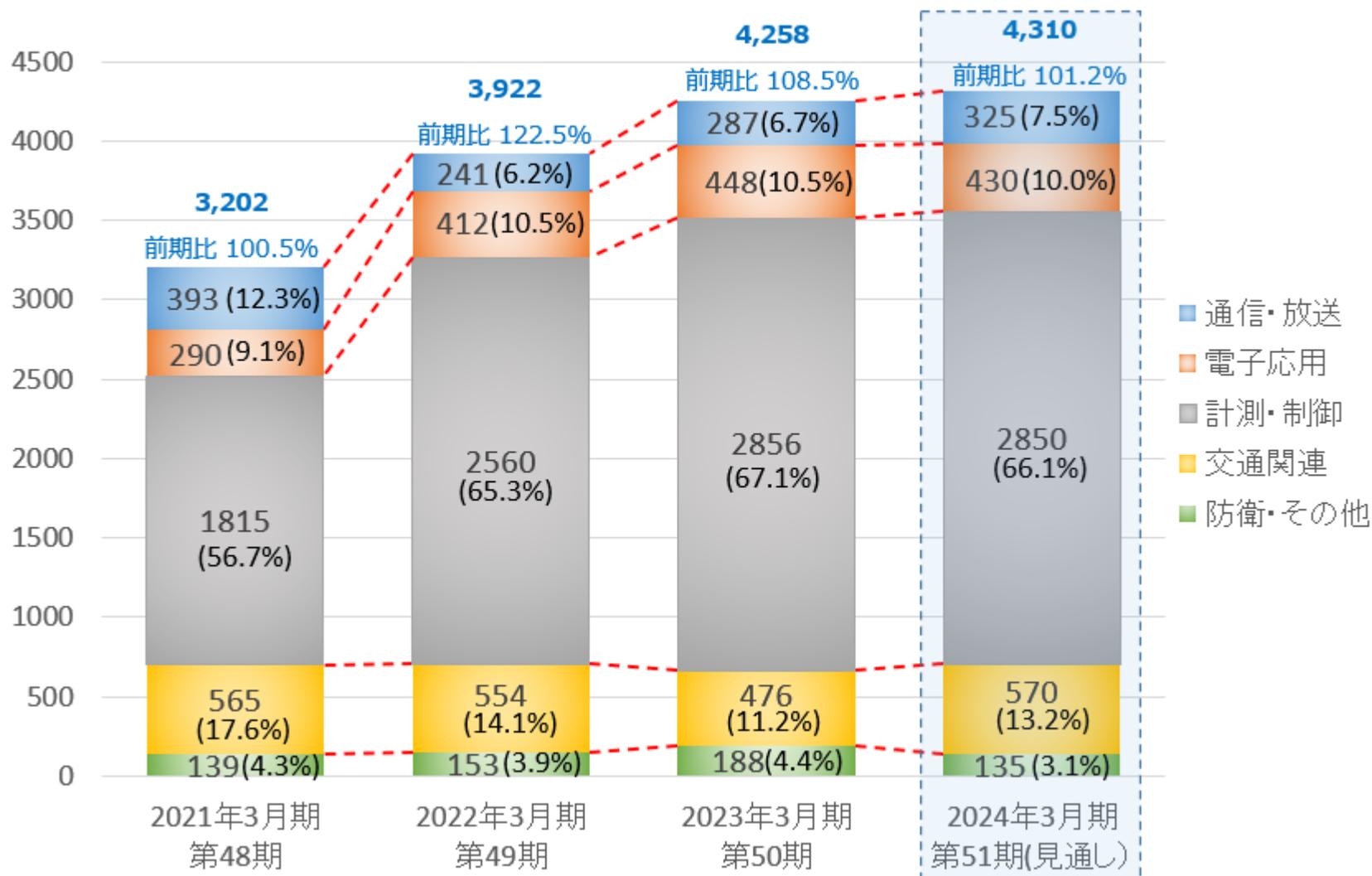


防衛・その他

- ✓ 前期は前々期からの期ズレ分上積みがあったが今期は無し
- ✓ 今期は例年並みを予想

連結応用分野別売上推移

単位：百万円



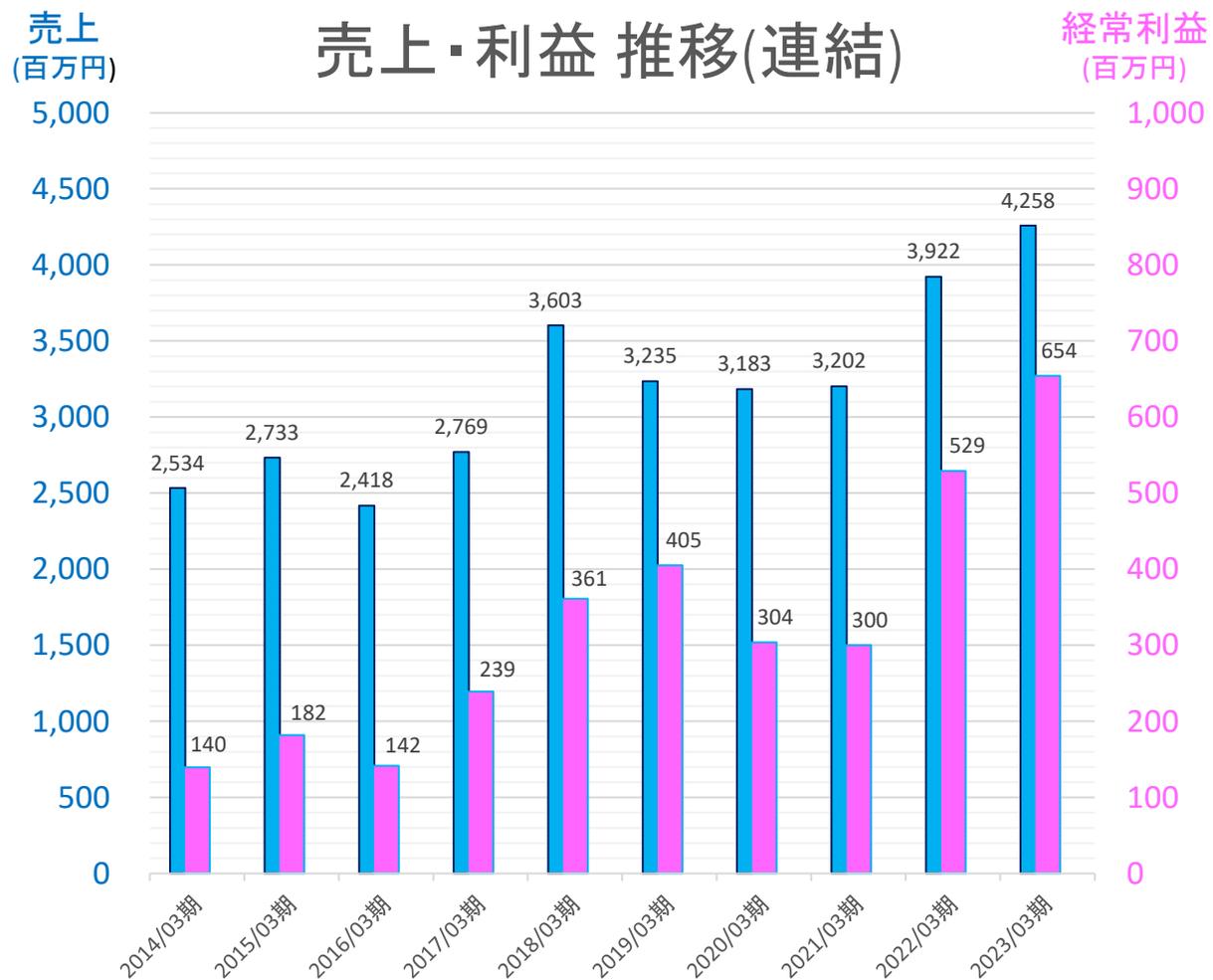


成長への取り組み

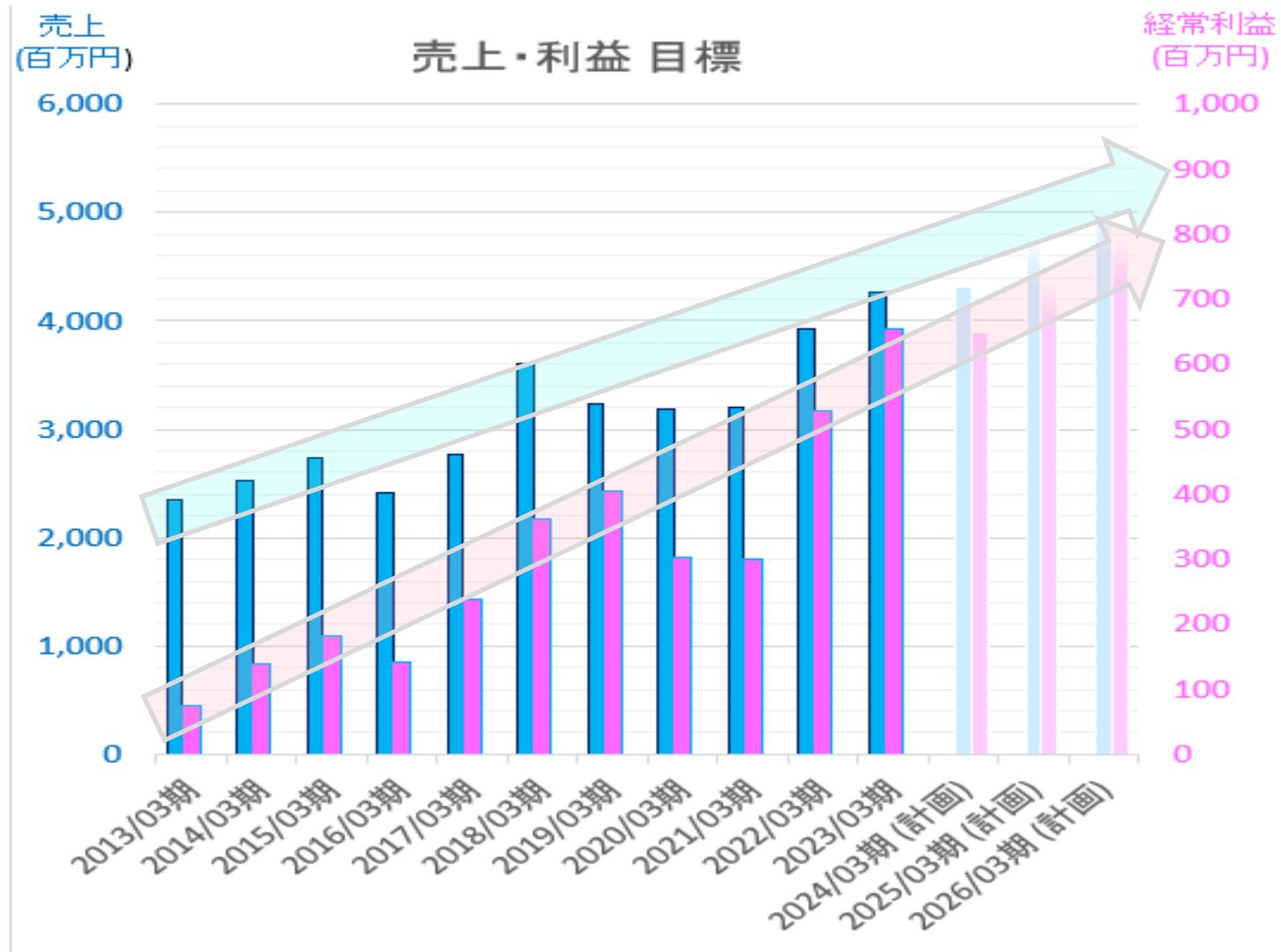
直近10年間の業績推移

売上 : 25.3億円→42.5億円

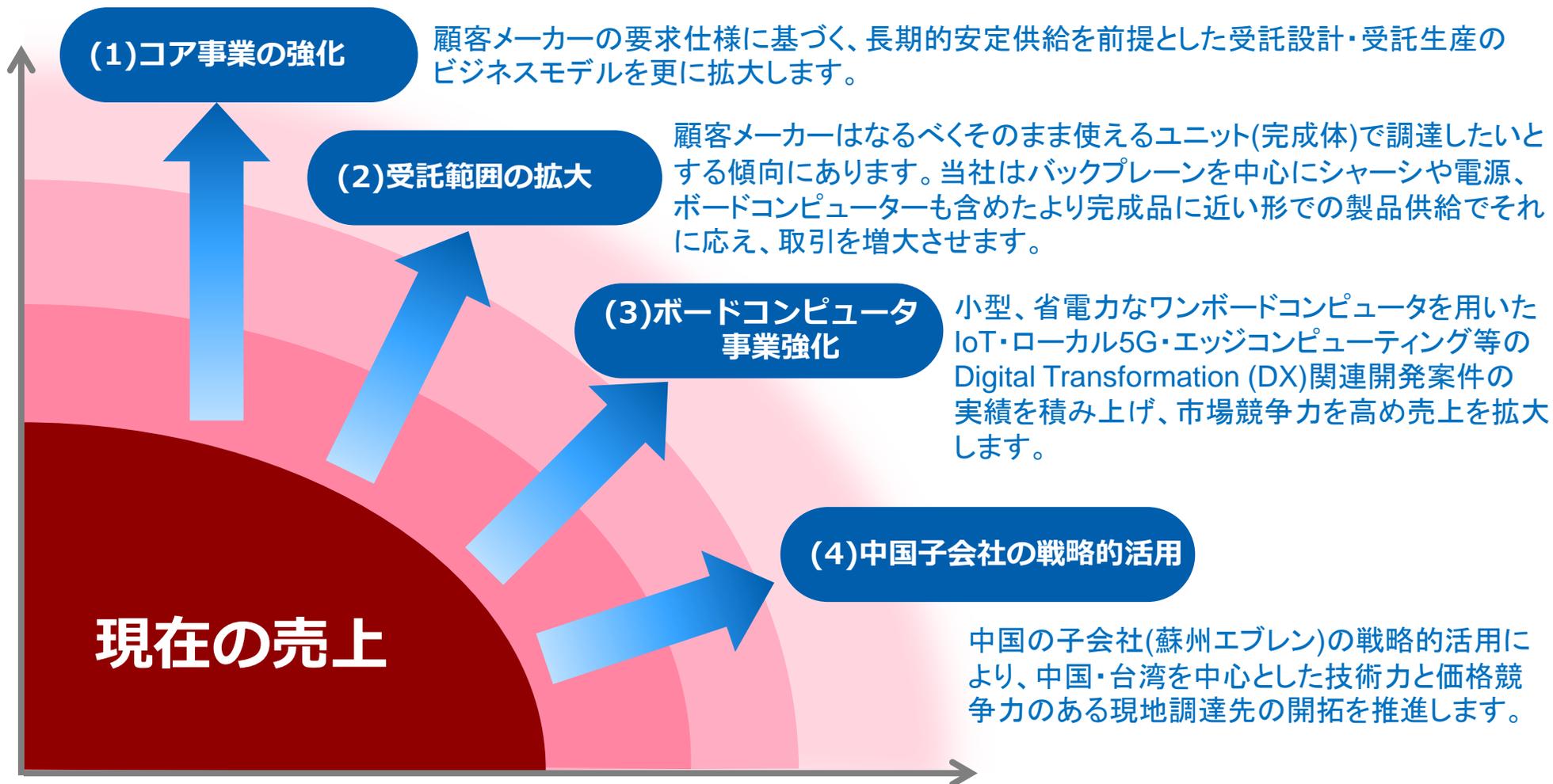
経常利益 : 1億40百万円→6億54百万円



年率10%~15%成長を目標として成長路線を堅持



より価値のあるソリューションの提供を通して企業価値の拡大を目指す



(1) コア事業の強化

顧客メーカーの要求仕様に基づく 受託設計・受託生産・長期的安定供給のビジネスモデルを更に拡大します。

大手システムメーカーの動向

過去

大手メーカーは設計・部材調達・生産など全てのプロセスを自社で完結していたが……

製品開発期間短縮の必要性の高まり

慢性的な技術リソース不足

技術の高度化・開発費の増大

今後

「選択と集中」が進み、ノウハウのある専門メーカーとの協業が拡大する

専門メーカーとしての優位性（**短納期・低コスト・高品質**）を生かし顧客メーカーとの協業を通じてノウハウや設計資産を蓄積

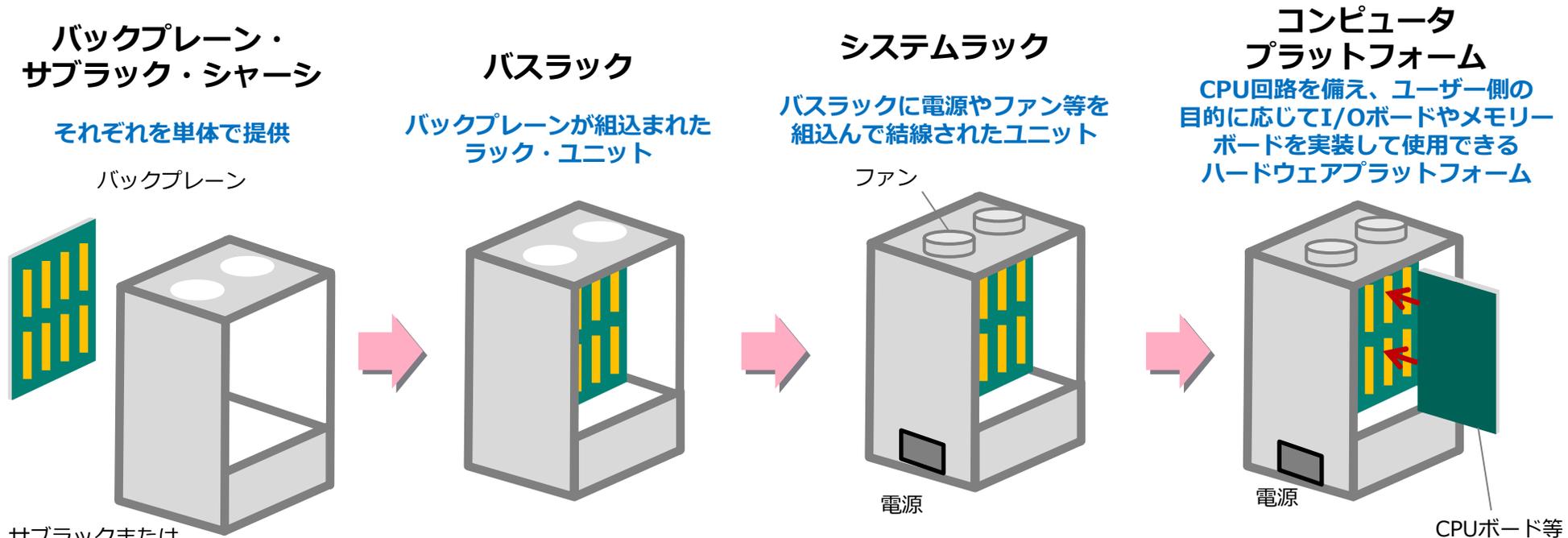
- ・類似案件の受注拡大
- ・事業領域の拡大
- ・要素技術の開発・拡充
（**冷却構造、耐電磁波構造**等）
- ・部品共通化による調達力の強化
- ・標準製品、システムパーツの拡充
（**FANアラームボード、標準部材**等）
- ・生産拡大に伴う生産設備増強

市場における優位性増大 = 事業拡大へ

(2) 受託範囲の拡大

当社の顧客メーカーは、部品をバラバラで調達する事をやめ、なるべくそのまま使えるユニット(完成体)で調達したいとする傾向にあります。

お客様が本来の研究開発活動にリソースを集中していただけるよう、当社の受託範囲がより完成品に近い形となるよう供給体制を整備・拡充し、お客様の多様なニーズに応えます。



年々構成レベルの高い（完成品に近い）製品に対する需要が増加する傾向

受託範囲の拡大による業績拡大

(3) ボードコンピュータ事業強化

技術革新で小型化・低消費電力化が進み、IoT・ローカル5G・エッジコンピューティング等、小型ワンボードコンピュータを使用して実現するDigital Transformation (DX)関連の開発案件が増加している。

- ・ 高電圧・大容量直流遮断器（洋上風力発電向送電用途）
- ・ 半導体検査装置用カメラモジュール（高速画像処理用途）
- ・ 次世代ワイヤーボンダーコントローラー（システム制御）
- ・ フィールドバス対応ロードセルアンプ（プラント管理用途）
- ・ 省エネ型スーパーコンピューター（AI用途）
- ・ AI画像処理システム（監視カメラ用途、FAカメラ用途等）
- ・ ショットピーニング用AEセンサーモジュール（FA用途）

※現在進行中の開発案件抜粋

(4) 中国子会社の活用強化

中国の子会社(蘇州エブレン)の戦略的活用により、中国・台湾を中心とした技術力と価格競争力のある現地の部材調達先の開拓を推進します。現地企業および日系の進出企業へ現地生産によるコスト競争力のある製品を提供します。



蘇州惠普聯電子有限公司
概要

会社名	蘇州惠普聯電子有限公司
本社所在地	中華人民共和国江蘇省蘇州市
創業開始	2002年9月
資本金	82百万円
株主構成	当社100%
事業内容	バックプレーン及びバスラック等の製造販売及び輸出入、部材の現地生産調達先の開拓

本資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、確信等は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかわる仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって予測数値とは異なる可能性があるため、本資料のみに全面的に依拠することは控えていただきますようお願い申し上げます。

また、本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、ご自身のご判断において行われますようお願い申し上げます。

ご清聴ありがとうございました。

EBRAIN